

2008年3月期 第1四半期決算に関する補足資料

PAGE 1/2

億円未満は切り捨て表示しています

1. 決算概要

(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第1四半期 2006.4-2006.6	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	増減率
売上高	1,792	2,124	18.6 %
営業利益	258	430	66.4 %
経常利益	267	411	54.0 %
税前利益	273	424	55.5 %
当期純利益	162	261	60.9 %

2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第1四半期 2006.4-2006.6	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	増減率
半導体製造装置			
国内	332	316	4.9 %
米国	279	211	24.4 %
欧州	137	79	42.5 %
韓国	180	214	18.9 %
台湾	260	625	139.8 %
中国	38	138	263.8 %
東南アジア他	30	73	137.2 %
海外計	926	1,341	44.7 %
計	1,259	1,657	31.7 %
FPD製造装置			
国内	111	108	2.8 %
韓国	37	64	72.7 %
台湾	92	40	56.2 %
中国・東南アジア	47	0	98.4 %
海外計	177	105	40.6 %
計	289	214	26.0 %
電子部品・情報通信機器			
国内	226	231	2.1 %
海外	13	20	47.1 %
計	240	251	4.7 %
その他			
国内	2	1	54.9 %
海外	-	-	-
計	2	1	54.9 %
連結合計			
国内	673	657	2.4 %
海外	1,118	1,467	31.2 %
計	1,792	2,124	18.6 %

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

単位:億円

	2007年3月期 第1四半期 2006.4-2006.6	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	増減率
産業用電子機器			
売上高	1,583	1,875	18.4 %
営業費用	1,329	1,454	9.3 %
営業利益	253	421	66.1 %
電子部品・情報通信機器			
売上高	212	254	19.5 %
営業費用	208	245	18.0 %
営業利益	4	8	89.1 %
消去又は全社			
売上高	4	5	-
営業費用	4	5	-
営業利益	0	0	68.7 %
連結			
売上高	1,792	2,124	18.6 %
営業費用	1,533	1,694	10.5 %
営業利益	258	430	66.4 %

4. 受注高

PAGE 2/2

(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第1四半期 2006.4-2006.6	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	増減率
半導体製造装置	1,926	1,452	24.6%
FPD製造装置	296	41	86.0%
電子部品・情報通信機器	276	275	0.4%
その他	2	1	54.9%
合計	2,502	1,770	29.2%

5. 受注残高

(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第1四半期 2006.4-2006.6	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	増減率
半導体製造装置	3,158	3,864	22.3%
FPD製造装置	997	479	51.9%
電子部品・情報通信機器	163	164	0.6%
合計	4,319	4,508	4.4%

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第1四半期 2006.4-2006.6	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	増減率
設備投資額	47	70	48.9%
減価償却実施額	42	46	8.9%
研究開発費	126	148	17.5%

- \* 前下半期より、従来「産業用電子機器」セグメントに区分しておりました「コンピュータ・ネットワーク」を「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。なお、2007年3月期第一四半期については、変更前の区分により表示しております。
- \* 当社の主力製品である半導体製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。